

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：桂嫚婷

電話：03-5918009

E-mail：manting@itri.org.tw



1120017028011

241403 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

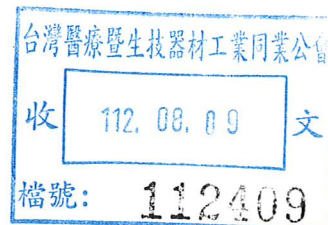
發文日期：中華民國 112 年 08 月 08 日

發文字號：工研轉字第 1120017028 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文



主旨：本院擬舉辦「112 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案」公開招標活動，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「112 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案」（40 案 80 件專利）之公開招標活動（讓與標的詳如附件）。

二、「讓與標的」共分為四個類別：

- （一）醫藥：7 案 11 件；
- （二）體外診斷：4 案 9 件；
- （三）再生醫學：4 案 11 件；
- （四）醫療電子：25 案 49 件。

三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：

（一）本案截標日為民國（下同）112 年 8 月 31 日，開標包含初審（112 年 9 月 7 日）及複審（決標日為 112 年 9 月 21 日），投標廠商於通過初審後，始進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。

(二) 詳細投標訊息及讓與標的資料，請參考工研院研發成果公告網站：

(https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1217603647476625236)

(三) 公開說明會資訊：

1、舉辦時間：112 年 8 月 18 日 14 時舉辦。

2、舉辦地點：採取線上方式辦理。

3、報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 8 月 17 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「112 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 8 月 17 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 桂小姐

電話：(03) 591-8009

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：ManTing@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長



依本院權責劃分規定授權業務主管決行



112 年度工研院生醫與醫材研究所 醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 40 案 80 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」共分為：

- （一）醫藥：7 案 11 件；
- （二）體外診斷：4 案 9 件；
- （三）再生醫學：4 案 11 件；
- （四）醫療電子：25 案 49 件。

「讓與標的」含共有專利，並已預先取得共有人之同意。「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）112 年 8 月 18 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 8 月 17 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「112 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案：公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 8 月 17 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 112 年 8 月 31 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：



(一) 本讓與案採通訊或親送方式投標。

投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1. (密封) 價格封。
2. 押標金。
3. 公司設立證明文件 (如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
4. 近兩年財報資料。(如新創公司成立未滿兩年，請檢附成立迄今之財報資料。)
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)

(前述全部資料文件等，以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「112 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案投標」，於截標日 112 年 8 月 31 日 17 時整 (含) 前 (以送達收據為憑) 掛號寄達或親送至：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 桂小姐收。

(二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表及商業營運計畫書中詳細敘明，並於公司基本資料暨運用規劃表敘明境外實施金額。

(三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介 (20%)
2. 公司財務狀況 (20%)
3. 公司營運／研發能力 (20%)
4. 「讓與標的」運用規劃 (30%)
5. 國內產業效益 (10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四) 投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。

(「讓與標的」以同一發明為一案。)

(五) 本讓與案不得共同投標或重複投標。

(六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

(一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。



於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起10個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格，但經工研院同意者，不在此限。

(二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。

(三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

(一) 投標時間截止後之投標。

(二) 開標前業已公告停止本讓與案交易程序。

(三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。

(四) 投標單附加任何成交條件者。

(五) 「投標文件」之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。

(六) 「投標文件」有所缺漏者。但押標金不足或商業營運計畫書份數不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於複審前未能補足者，其投標為無效。

(七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果(包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果)轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。

(八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方式：

(一) 分為初審(112年9月7日)及複審(112年9月21日)，投標廠商於通過初審後，始能進入複審。工研院會另行通知通過初審之投標廠商依通知時間進行複審。

(二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。

(三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書等進行形式審查及確認。

(四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會會議就商業營運計畫書、價格等進行複審，投標廠商於複審時應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。

(五) 投標廠商若有境外實施需求，除應依「五、投標方法」第(二)點敘明外，並應於複審時報告說明。

(六) 複審時，工研院開標審議委員會會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標金額最高且高於底價者得標。若有二(含)



家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商有一次優先加價機會，若此優先加價仍無超過底價，之後則由超過及格分之所有投標廠商同時議價，議價次數以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上超過及格分之投標廠商之投標金額均超過底價且相同，得提供該投標廠商議價機會，並以高價者得標。議價次數以三次為限，經三次議價後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。（議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書）

- （七）開標時將請律師到場監標。
- （八）開標結果依政府法令相關規定，須向主管機關呈報者，則於主管機關同意後始生效力。
- （九）工研院將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
- （十）對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

九、契約事項：

- （一）得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
- （二）得標廠商如屆期末與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- （三）得標廠商與工研院簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- （四）遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
- （五）得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
- （六）得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約



書」經雙方依法簽章報經濟部及共有人同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部及共有人之意見並無影響能力。

- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部及/或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：
1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。
- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
- (十) 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
- (十一) 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府



法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：

- 1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
- 2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
- 3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
- 4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

（十二）得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

- 1.得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
- 2.得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
- 3.為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

（十三）得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前書面通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與「後手」之讓與契約，否則即視為得標廠商已將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」，工研院得依前述約定行使相關權利。

（十四）得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至



第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

(十五) 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

(十六) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

(十七) 得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 桂小姐。

電話：(03) 591-8009。

傳真：(03) 582-0466。

電子信箱：ManTing@itri.org.tw。

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。



附件：專利清單

(一) 醫藥：7 案 11 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
1	1	P56990003US	人源化之單株抗體、其核苷酸序列與其用途	美國	獲證	US8691226	20140408	20320827	經濟部技術處	工研院	
	2	P56990003TW	人源化之單株抗體、其核苷酸序列與其用途	中華民國	獲證	TW1538918	20160621	20301019	經濟部技術處	工研院	
	3	P56990003CN	人源化之單克隆抗體、其氨基酸序列與核酸序列與其用途	中國大陸	獲證	CN102464718	20140813	20301104	經濟部技術處	工研院	
2	4	P56970004TW	調節細胞激素分泌之用途	中華民國	獲證	TW1435727	20140501	20291227	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
3	5	P56960002TW	誘導免疫細胞產生干擾素與活化 Toll 樣受體之中草藥萃取物及其製備方法	中華民國	獲證	TW1366466	20120621	20280507	經濟部技術處	工研院	曾專屬授權
	6	P56960002JP	誘導免疫細胞產生干擾素與活化 Toll 樣受體之中草藥萃取物及其製備方法	日本	獲證	JP4980305	20120427	20280629	經濟部技術處	工研院	曾專屬授權
	7	P56960002CN	誘導免疫細胞產生干擾素和活化 TOLL 樣受體的中草藥萃取物及其製備方法	中國大陸	獲證	CN101590105	20121031	20280529	經濟部技術處	工研院	曾專屬授權
4	8	P56020026TW	促進幹細胞分化為胰島素生成細胞之方法	中華民國	獲證	TW1472618	20150211	20340114	經濟部技術處	工研院	
5	9	P56010034TW	植物藥材鑑別方法及其資料庫以及引子對	中華民國	獲證	TW1484038	20150511	20321227	經濟部技術處	工研院	
6	10	P56010026TW	疫苗佐劑、疫苗組合物與牛樟芝子實體之多醣體用於製備一疫苗佐劑的用途	中華民國	獲證	TW1522112	20160221	20321210	經濟部技術處	工研院	
7	11	P27040015TW	分離按油醇物質的方法、孔洞高分子材料及其製備方法	中華民國	獲證	TW1554566	20161021	20351222	經濟部技術處	工研院	

(二) 體外診斷：4 案 9 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
8	12	P64970044US	連續偵測待測樣本中葡萄糖濃度的方法、其套組與使用生物感測器的方法	美國	獲證	US8415170	20130409	20310720	經濟部技術處	工研院	
	13	P64970044TW	使用生物感測器的方法及偵測待測樣本中葡萄糖濃度的套組	中華民國	獲證	TW1484186	20150511	20290525	經濟部技術處	工研院	
	14	P64970044CN	用於連續檢測樣本中葡萄糖濃度的方法、試劑盒和使用生物傳感器的方法	中國大陸	獲證	CN101936980	20160316	20290630	經濟部技術處	工研院	
9	15	P56010024TW	用於生物樣本處理之組合物及使用其之核酸擴增方法	中華民國	獲證	TW1555849	20161101	20321227	經濟部技術處	工研院	
	16	P56010024CN	用於生物樣本處理之組合物及使用其之核酸擴增方法	中國大陸	獲證	CN103571825	20160316	20330530	經濟部技術處	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
10	17	P56010023US	用於分離核酸的組合物及方法	美國	獲證	US9315800	20160419	20331003	經濟部技術處	工研院	
	18	P56010023TW	用於分離核酸的組合物及方法	中華民國	獲證	TWI555850	20161101	20321227	經濟部技術處	工研院	
	19	P56010023CN	用於分離核酸的組合物及方法	中國大陸	獲證	CN103571824	20160413	20330509	經濟部技術處	工研院	
11	20	P27030055TW	檢測哈威氏弧菌之探針、方法及套組	中華民國	獲證	TWI539003	20160621	20341230	經濟部技術處	工研院	

(三) 再生醫學：4 案 11 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
12	21	P56990024TW	應用於軟硬組織修復與再生之生醫材料	中華民國	獲證	TWI449546	20140821	20310906	經濟部技術處	工研院	
	22	P56990024CN	應用於軟硬組織修復與再生的生物醫學材料	中國大陸	獲證	CN102973982	20141210	20311117	經濟部技術處	工研院	
13	23	P56950011US	創新型動態脊椎固定系統	美國	獲證	US9398926	20160726	20340301	經濟部技術處	工研院	
14	24	P56030013TW	具有引導功能之手術裝置	中華民國	獲證	TWI561207	20161211	20341225	經濟部技術處	工研院	
15	25	P56010004US	細胞培養系統、以及無血清細胞培養方法	美國	獲證	US8956871	20150217	20330220	經濟部技術處	工研院	
	26	P56010004TW	細胞培養系統、以及無血清細胞培養方法	中華民國	獲證	TWI512103	20151211	20321111	經濟部技術處	工研院	
	27	P56010004GB	以合成材料為基質的細胞培養系統及方法	英國	獲證	EP2730593	20151118	20321210	經濟部技術處	工研院	
	28	P56010004FR	以合成材料為基質的細胞培養系統及方法	法國	獲證	EP2730593	20151118	20321210	經濟部技術處	工研院	
	29	P56010004DE	以合成材料為基質的細胞培養系統及方法	德國	獲證	EP2730593	20151118	20321210	經濟部技術處	工研院	
	30	P56010004CN	細胞培養裝置、以及無血清細胞培養方法	中國大陸	獲證	CN103805510	20160601	20321216	經濟部技術處	工研院	
	31	P56010004CH	以合成材料為基質的細胞培養系統及方法	瑞士	獲證	EP2730593	20151118	20321210	經濟部技術處	工研院	

(四) 醫療電子：25 案 49 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
16	32	P64980003US	母體胎兒監視裝置與方法	美國	獲證	US8483810	20130709	20311019	經濟部技術處	工研院;國立台灣大學醫學院附設醫院	
	33	P64980003TW	母體胎兒監視裝置與方法	中華民國	獲證	TWI392480	20130411	20291020	經濟部技術處	工研院;國立台灣大學醫學院附設醫院	
	34	P64980003CN	母體胎兒監視裝置與方法	中國大陸	獲證	CN102068249	20130501	20291122	經濟部技術處	工研院;國立台灣大學醫學院附設醫院	
17	35	P56030011TW	心電圖量測裝置及其控制方法	中華民國	獲證	TWI552723	20161011	20341127	經濟部技術處	工研院	
18	36	P56030004US	攝像裝置與光場攝像鏡頭	美國	獲證	US9438778	20160906	20350305	經濟部技術處	工研院	
	37	P56030004TW	攝像裝置與光場攝像鏡頭	中華民國	獲證	TWI569087	20170201	20341211	經濟部技術處	工研院	



工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
19	38	P56020012TW	X 光平板感測器之殘留電荷消除方法及裝置	中華民國	獲證	TW1535289	20160521	20331121	經濟部技術處	工研院	
20	39	P56010054TW	主動脈血管量測探針、裝置及主動脈管徑的測量方法	中華民國	獲證	TW1536959	20160611	20331024	經濟部技術處	工研院	
	40	P56010054CN	主動脈血管量測探針、裝置及主動脈管徑的測量方法	中國大陸	獲證	CN103892799	20160914	20331222	經濟部技術處	工研院	
21	41	P56010049US	多能量相位對比 X 光成像系統設計	美國	獲證	US9360439	20160607	20341001	經濟部技術處	工研院	
	42	P56010049TW	成像系統	中華民國	獲證	TW1552727	20161011	20331119	經濟部技術處	工研院	
22	43	P56010030TW	生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法	中華民國	獲證	TW1544899	20160811	20321227	經濟部技術處	工研院	
	44	P56010030CN	生理信號測量裝置及生理信號測量方法	中國大陸	獲證	CN103908262	20160427	20321227	經濟部技術處	工研院	
23	45	P56010018TW	感測裝置及其像素結構	中華民國	獲證	TW1531233	20160421	20321212	經濟部技術處	工研院	
	46	P56010018CN	傳感裝置及其像素結構	中國大陸	獲證	CN103860189	20160928	20321225	經濟部技術處	工研院	
24	47	P56000023CN	超聲波能量轉換裝置以及超聲波成像系統與方法	中國大陸	獲證	CN103181779	20160113	20320304	經濟部技術處	工研院	
25	48	P56000012US	訊號處理裝置及訊號處理方法	美國	獲證	US9314176	20160419	20350218	經濟部技術處	工研院	
26	49	P51980015US	具有長焦深之光學成像系統及光學系統	美國	獲證	US8451368	20130528	20310714	經濟部技術處	工研院	
	50	P51980015TW	具有長焦深之光學成像系統及光學系統	中華民國	獲證	TW1525346	20160311	20290831	經濟部技術處	工研院	
27	51	P51020055US	高幀率超音波成像方法與裝置	美國	獲證	US9864059	20180109	20360529	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
28	52	P51020013US	光學定址承載器	美國	獲證	US9117149	20150825	20330118	工研院	工研院	
	53	P51020013TW	光學定址承載器	中華民國	獲證	TW1481848	20150421	20331030	工研院	工研院	
29	54	P51010171US	微縮影像投影裝置	美國	獲證	US9323039	20160426	20340822	經濟部技術處	工研院	
30	55	P51010155US	虛像顯示裝置	美國	獲證	US9323059	20160426	20331228	經濟部技術處	工研院	
	56	P51010155TW	虛像顯示裝置	中華民國	獲證	TW1534475	20160521	20321220	經濟部技術處	工研院	
31	57	P51010147US	影像重建方法與系統及影像建構方法與系統	美國	獲證	US9101326	20150811	20330614	經濟部技術處	工研院	
	58	P51010147TW	影像重建方法與系統及影像建構方法與系統	中華民國	獲證	TW1506272	20151101	20330218	經濟部技術處	工研院	
	59	P51010147CN	影像重建方法與系統及影像建構方法與系統	中國大陸	獲證	CN103720482	20160120	20330502	經濟部技術處	工研院	
32	60	P51010085CN	檢測鈣化或微鈣化的光聲成像方法	中國大陸	獲證	CN103705213	20160217	20330929	經濟部技術處	工研院	
33	61	P51010084US	超音波發射電路及其時間延遲校正方法	美國	獲證	US9244161	20160126	20340519	經濟部技術處	工研院	
	62	P51010084TW	超音波發射電路及其時間延遲校正方法	中華民國	獲證	TW1456240	20141011	20321111	經濟部技術處	工研院	
	63	P51010084CN	超聲波發射電路及其時間延遲校正方法	中國大陸	獲證	CN103812477	20160824	20321225	經濟部技術處	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
34	64	P51010078US	投影鏡頭、使用其之投影裝置及光驅動微粒子裝置	美國	獲證	US9134513	20150915	20340410	經濟部技術處	工研院	
	65	P51010078TW	投影鏡頭、使用其之投影裝置及光驅動微粒子裝置	中華民國	獲證	TWI498593	20150901	20321105	經濟部技術處	工研院	
	66	P51010078CN	投影鏡頭、使用其之投影裝置及光驅動微粒子裝置	中國大陸	獲證	CN103809267	20160217	20330220	經濟部技術處	工研院	
35	67	P51010045US	光纖式穿透影像擷取方法及其裝置	美國	獲證	US8873034	20141028	20330317	經濟部技術處	工研院	
	68	P51010045TW	光纖式穿透影像擷取方法及其裝置	中華民國	獲證	TWI481853	20150421	20321218	經濟部技術處	工研院	
	69	P51010045CN	光纖式穿透影像擷取方法及其裝置	中國大陸	獲證	CN103876701	20160629	20330204	經濟部技術處	工研院	
36	70	P51010040TW	電容性負載驅動電路以及脈衝激發裝置	中華民國	獲證	TWI477078	20150311	20321016	經濟部技術處	工研院	
	71	P51010040CN	電容性負載驅動電路以及脈衝激發裝置	中國大陸	獲證	CN103780229	20160309	20330501	經濟部技術處	工研院	
37	72	P51000105TW	光學檢測方法	中華民國	獲證	TWI470205	20150121	20311229	經濟部技術處	工研院	
38	73	P51000099US	調整針孔位置與大小之光學裝置及其方法	美國	獲證	US8822902	20140902	20330301	經濟部技術處	工研院	
	74	P51000099TW	調整針孔位置與大小之光學裝置及其方法	中華民國	獲證	TWI467155	20150101	20311213	經濟部技術處	工研院	
39	75	P51000051US	超音波影像對齊裝置及其方法	美國	獲證	US8897521	20141125	20330314	經濟部技術處	工研院	
	76	P51000051TW	超音波影像對齊裝置及其方法	中華民國	獲證	TWI446897	20140801	20310818	經濟部技術處	工研院	
	77	P51000051CN	超音波影像對齊裝置及其方法	中國大陸	獲證	CN102956030	20160120	20311101	經濟部技術處	工研院	
40	78	P51000049US	超音波接收模組、方法及系統	美國	獲證	US9449597	20160920	20350302	經濟部技術處	工研院	
	79	P51000049TW	超音波接收模組、方法及系統	中華民國	獲證	TWI440878	20140611	20311026	經濟部技術處	工研院	
	80	P51000049CN	超聲波接收裝置、方法及系統	中國大陸	獲證	CN103093749	20150318	20311204	經濟部技術處	工研院	

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。